

Bauteilprogrammierung:
Mehr Flexibilität, höhere Kapazität und kürzere Lieferzeiten

Bauteilprogrammierung auf neuem Leistungsniveau
Mit einer zusätzlichen Investition in einen modernen Programmiervollautomaten reagieren wir auf den kontinuierlich steigenden Bedarf der Branche an programmierbaren Bauteilen – insbesondere an Komponenten mit immer größeren Speicherbereichen.
Ab dem **4. Quartal** wird das neue System einsatzfähig sein und die bestehende Programmierkapazität deutlich erweitern. Abhängig von der jeweiligen Programmierzeit können damit **zusätzliche 2 bis 6 Millionen Bauteile** pro Jahr bearbeitet werden. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eines: mehr verfügbare Kapazität und eine nochmals höhere Flexibilität bei der Umsetzung ihrer individuellen Anforderungen.

Flexibilität für kleine und mittlere Serien
Bei der Auswahl der neuen Anlage wurde besonderes Augenmerk auf die **Flexibilität des Systems** gelegt. Seine besondere Stärke spielt der Programmiervollautomat bei **kleinen und mittleren Serien** aus. Damit eignet sich die Anlage ideal für Anwendungen, bei denen häufig wechselnde Bauteiltypen, Varianten und Losgrößen eine hohe Anpassungsfähigkeit erfordern.



Das System deckt den aktuellen **„Mainstream" der programmierbaren Bauteile** ab und ermöglicht die Verarbeitung einer breiten Palette unterschiedlicher Speichertypen und Mikrocontroller. Dazu zählen unter anderem **EEPROMs, NAND Flash, NOR Flash, MCU, eMMC und UFS**.

Auch bei den Gehäuseformen bietet die Anlage eine hohe Variantenbreite. Unterstützt werden unter anderem **SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, QFP, QFN und BGA** – bis hin zu einer minimalen Bauteilgröße von lediglich **2 × 2 mm**. Eine hochpräzise Positionierung mit einer Genauigkeit von **± 0,01 mm** gewährleistet dabei eine zuverlässige und reproduzierbare Verarbeitung.

Durchgängiger Prozess vom Eingang bis zum fertigen Bauteil
Die Flexibilität zeigt sich auch bei der Materialzuführung und -ausgabe. Als Eingangsmedien können **Trays, Tubes sowie Tapes (Gurte)** mit Breiten von 8, 12, 16, 24, 32 und 44 mm eingesetzt werden. Die Ausgabe ist wahlweise auf **Tray oder Tape** möglich; dabei werden Gurte mit 8 bis 44 mm Breite und einer Tiefe von 14 mm unterstützt.

S&P Dienstleistungen in der Mikroelektronik GmbH
Willi-Bleicher-Straße 9 · 73230 Kirchheim unter Teck
Tel +49 7021 5098-0 · info@sp-mikroelektronik.de

Geschäftsführer: Andreas Plescher,
Georgios Lagospiris, Ioannis Pateloudis
Sitz: Kirchheim unter Teck · HRB 231520 Stuttgart
USt-IdNr. DE195968018 · Steuer-Nr. 69030/03139

Volksbank Mittlerer Neckar eG
IBAN: DE10612901200335760007
BIC: GENODES1NUE

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE69611500200103086031
BIC: ESSLDE66XXX



Ergänzt wird der automatisierte Prozess durch integrierte Inspektionsmöglichkeiten. Eine **Prüfung des Pin 1 und der Bauteilmarkierung von oben** ist Bestandteil des Systems. Auch das **automatisierte Aufbringen von Etiketten**, beispielsweise aus Polyimid, ist möglich.

Damit lassen sich Programmierung, Prüfung und Kennzeichnung effizient in einen durchgängigen Prozess integrieren. Gerade bei häufig wechselnden Klein- und Mittelserien schafft dies die notwendige Flexibilität, um unterschiedliche Kundenanforderungen wirtschaftlich und zuverlässig umzusetzen.

Investition in Zukunft und Liefersicherheit

Mit der Investition in die neueste Technologie bauen wir unsere Kompetenz im Bereich der Bauteilprogrammierung konsequent weiter aus. Die zusätzliche Kapazität ermöglicht es uns, auf steigende Stückzahlen und wachsende Anforderungen schneller zu reagieren und gleichzeitig unsere Flexibilität bei unterschiedlichen Bauteilvarianten und Losgrößen zu erhalten.

Mehr Kapazität, hohe Flexibilität und modernste Programmiertechnologie

Mit dem neuen Programmiervollautomaten schaffen wir die Voraussetzungen, unseren Kunden auch künftig kurze Reaktions- und Lieferzeiten sowie eine zuverlässige und wirtschaftliche Bauteilprogrammierung zu bieten.

S&P Dienstleistungen in der Mikroelektronik GmbH
Willi-Bleicher-Straße 9 · 73230 Kirchheim unter Teck
Tel +49 7021 5098-0 · info@sp-mikroelektronik.de

Geschäftsführer: Andreas Plescher,
Georgios Lagospiris, Ioannis Pateloudis
Sitz: Kirchheim unter Teck · HRB 231520 Stuttgart
USt-IdNr. DE195968018 · Steuer-Nr. 69030/03139

Volksbank Mittlerer Neckar eG
IBAN: DE10612901200335760007
BIC: GENODES1NUE

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE69611500200103086031
BIC: ESSLDE66XXX